

プロジェクトにおける加工・組立技術

	高機能メンテナンス	マイクロファクトリ	医療応用
材料	金属・セラミック・半導体・樹脂		
除去加工	非球面微小光学面加工技術、マイクロMIM技術 超音波振動研削技術、3次元微細放電加工技術 PZT薄板加工技術、高速ドライエッチング技術 光エネルギービーム励起素子分離・配線技術 シリコン微細加工技術、圧電薄膜微細加工技術	3次元形状転写技術 イメージバンドル細径化技術 マイクロ電解加工技術 マイクロ光加工技術	エキシマレーザー加工技術
付加加工	円筒薄膜磁石形成技術、流路表面修飾技術 圧電性薄膜作製技術無応力膜生成技術 形状記憶合金薄膜形成技術	薄膜永久磁石製作技術	イオンアシスト蒸着・電鍍技術
複合加工	微細溝形成技術、円筒面膜加工技術 立体犠牲層成膜・エッチング技術、シェルボディ形成 3次元巻線技術、圧電薄膜積層技術、微小金型研磨技術 薄膜多層フィルム加工技術、高密度積層コイル形成技術 微細圧電セラミクス製作技術、高密度貫通電極形成技術 ディープエッチX線リソグラフィ技術	複合マイクロ超精密加工 湿式3次元加工技術	カテーテル成形技術
組立・接合	異種材料接合技術、脱着可能接合技術 プリアセンブル技術（円筒積層プロセス）	微細接合技術	